

4971 **メック**

溝口 芳朗 (ミゾグチ ヨシロウ)

メック株式会社常務

高シェア誇る電子部品の表面処理剤順調に増収増益

◆業績のポイント

執行役員 松下太郎

平成 26 年 3 月期第 3 四半期の業績は、売上高 60 億 1 5 百万円(前年同期比 22.1 %増)、営業利益 12 億 38 百万円(同 64.6 %増)、経常利益 13 億 53 百万円(同 76.3 %増)、四半期純利益 9 億 33 百万円(同 64.8 %増)と、増収増益の結果になった。為替の影響として、売上高に 4 億 97 百万円増、営業利益には 82 百万円増が含まれている。

主力である薬品の売上高は 55 億 25 百万円(前年同期比 23.2 %増)、全体の売上高に占める割合は 91.9% (同 0.9 ポイント増)に拡大した。機械は 1 億 50 百万円(同 12.0 %増)、資材は 3 億 10 百万円(同 15.7 %増)となった。

海外売上高比率も 47.4%(前年同期比 2.1 ポイント増)に拡大している。なお、当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は 61.3%(同 0.1 ポイント減)である。

薬品の中でも主力の CZ の売上高は 27 億 80 百万円(前年同期比 17.7 %増)、CZ の薬品売上高に占める割合は 50.3%(同 2.4 ポイント減)となった。全体の粗利率は 64.1%(同 0.1 ポイント減)であった。

販売費及び一般管理費 26 億 19 百万円(前年同期比 8.6 %増)は、人件費や運賃を中心に増加した。また、前年同期は為替差損が発生したが、当第 3 四半期連結累計期間は為替差益 64 百万円を計上している。

連結貸借対照表では、おもに流動資産の増加に伴い資産合計が 120 億 70 百万円(前期末は 108 億 83 百万円)に増加した。

キャッシュフローの状況として、営業活動によるキャッシュフロー10 億 17 百万円(前年同期は 4 百万円)は、税金等調整前四半期純利益の増加に伴い大幅に増加した。投資活動によるキャッシュフロー69 百万円(同 1 億 8 百万円)、財務活動によるキャッシュフローはマイナス 2 億 19 百万円(同マイナス 3 億 99 百万円)の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は 27 億 11 百万円(同 15 億 38 百万円)となった。

◆四半期業績の推移

四半期連結売上高推移をみると、景気の低迷や円高の影響を受けた平成 24 年 3 月期第 4 四半期 14 億 49 百万円を底に回復傾向となり、平成 26 年 3 月期は第 2 四半期 20 億 24 百万円(前第 1 四半期は 17 億 37 百万円)、第 3 四半期 22 億 53 百万円と増加を続けている。

四半期連結営業利益の推移については、平成 26 年 3 月期の第 1 四半期 2 億 3 百万円(前年同期は 1 億 81 百万円)、第 2 四半期 3 億 97 百万円(同 2 億 8 百万円)、第 3 四半期 6 億 38 百万円(同 3 億 62 百万円)と増加している。連結経常利益、連結四半期純利益も、同様に回復傾向を示している。

品種別売上高の四半期推移(連結)として、圧倒的な割合を占める主力の薬品が平成 26 年 3 月期第 1 四半期 16 億 18 百万円(前年同期は 14 億 23 百万円)、第 2 四半期 18 億 94 百万円(同 15 億 8 百万円)、第 3 四半期

20 億 12 百万円(同 15 億 51 百万円)と増加している。

薬品別売上高の四半期推移(連結)として、銅表面処理剤が平成 26 年 3 月期第 1 四半期に 14 億 82 百万円(前年同期は 12 億 96 百万円)を占め、第 2 四半期 17 億 45 百万円(同 13 億 91 百万円)、第 3 四半期 18 億 50 百万円(同 14 億 35 百万円)と伸長した。

別の分類による薬品別売上高の四半期推移(連結)では、平成 26 年 3 月期第 3 四半期に密着向上剤 11 億 42 百万円(第 2 四半期は 10 億 87 百万円)、エッチング剤 7 億 67 百万円(同 7 億 16 百万円)、その他表面処理剤 1 億 2 百万円(同 90 百万円)と、いずれも増加している。

地域セグメント別売上高についても、平成 26 年 3 月期第 3 四半期に日本 12 億 89 百万円(第 2 四半期は 11 億 47 百万円)、アジア 8 億 37 百万円(同 7 億 61 百万円)、欧州 1 億 27 百万円(同 1 億 15 百万円)といずれも伸び、海外売上高比率は 47.3%(同 47.2%)となった。

平成 26 年 3 月期通期連結業績予想は本年 1 月 31 日付で上方修正し、売上高 78 億円(前期比 16.3 %増)、営業利益 13 億円(同 41.6 %増)、経常利益 14 億 50 百万円(同 51.5 %増)、当期純利益 10 億円(同 59.5%増)を計画している。

◆世界を拓くメックの技術

常務 溝口芳朗

メックが活躍できる分野として、大きな話題となっているウェアラブルが新たに加わった。すでに国内でも開発が動き始めており、「ウェアラブル元年」と認識している。

当社は、パソコンやスマートフォン、タブレット PC 向け等の電子部品の製造用薬品で世界的に高いシェアを獲得している。CZ は 1995 年に販売を開始し、業界のデファクトスタンダードとして進化を続けている。

世界を拓くメックの技術として、「密着向上技術」「微細配線形成技術」「金属表面処理技術」の三つに分類することができる。

密着向上技術では、物理密着技術(CZ シリーズ、V ボンド)、化学密着技術(フラットボンドシリーズ)をコア技術としている。微細配線形成技術には、既存の設備を活用したサブトラエ法技術(EXE シリーズ)、ディスプレイ関連で実績が拡大している ITO 処理技術(TP シリーズ)がある。金属表面処理技術では、表面粗化技術、選択エッチング技術により、電子基板以外の新たな市場に向けて展開を始めている。

新しい金属表面処理技術は、スマートフォン、車載、ゲーム機器に応用されている。売上実績はまだ電子基板に比較すると小さいが、有償サンプルによる評価の引き合いが多くなっている。車載向けでは認定に 3~5 年の期間を要するといった障壁もあるが、今後は家電などにも視野を広げ、金属表面処理技術の評価・採用を拡大していきたいと考えている。

◆事業領域の拡大を目指して

密着向上技術の応用はパソコンから始まり、近年ではスマートフォン、タブレット PC、サーバー、ウェアラブル機器、医療機器、自動車など、さまざまなアイテムに拡大している。市場の要求も早いスピードで微細化や高精細化が進み、当初は凹凸をつける物理的密着が中心であったが、現在は平滑処理による化学的密着へと移行しつつある。当社は他社に先がけて平滑処理の製品を販売しており、今後ビッグデータの処理などへの活用が増えると予想される。

2017 年までの密着向上技術のロードマップとして、「微細化」「高周波化」をキーワードに研究開発に取り組んでいる。すでに直近の開発は終了しており、引き続きパッケージおよび高周波基板において採用されるものと考えている。やはりトレンドは、エッチングレスと平滑処理、化学密着となっている。

高周波基板用密着向上剤では、化学密着剤フラットボンド GT プロセスの販売を昨年開始した。信号の周波

数が高くなるほど、電流の流れる銅の表皮深さは浅くなる。従来の CZ は 0.5~1.5 ミクロンの深さでエッチングしていたが、より電気信号の遅延を抑える要求の高まりに応じ、化学密着のみで平滑処理を可能としたのが GT プロセスである。今後、ルーターやネットワークへの活用が期待されている。

微細配線形成技術は、スマートフォン、テレビ、パソコン、タブレット PC などの電気基板に応用されつつあり、ディスプレイ COF(チップオンフィルム)には当社の EXE シリーズがデファクトスタンダードとなっている。現在、COF の細線パターンはおよそ 23 ミクロンピッチであるが、来年以降は 20 ミクロンピッチを下回る要求が出てくるものと思われる。テレビの大型化、高解像度が進んでいく中で、さらにチャレンジを続けていきたい。

金属表面処理技術では、樹脂と金属を直接接合させるコア技術を持っており、スマートフォン、タブレット PC、自動車関連分野を含め新しい市場で販売を始めている。今年の「クルマの軽量化技術展」に出展した際に取材を受け、新聞に掲載された経緯もあるが、3 年前から行っており、さまざまな金属の表面に凹凸をつけることで樹脂と接合させる低コスト・高品質の製品で、現在、用途および販路拡大の取り組みを進めている。

1990 年代は、電子基板製造関連分野と半導体やパッケージといった分野が離れていたが、近年はそれらが同じ円に入り飛躍的に伸びてきた。今後、パソコン、スマートフォン、タブレット、車載、家電が融合していく中で、当社はこの電子基板製造関連分野を軸として、スマートフォンを含めたディスプレイ関連分野やその他樹脂金属接合分野へ事業を拡大していきたい。

これからも成長し続けるために「グローバル展開を強化」「新製品の開発力強化」「トータル品質保証体制の強化」に取り組んでいく。メックの知名度は世界で飛躍的に高まっており、新たな拠点づくりを含めグローバル販売をさらに推進していきたい。

◆ 質 疑 応 答 ◆

四半期ごとの業績推移について、それぞれの要因を伺いたい。

平成 26 年 3 月期第 2 四半期から第 3 四半期にかけての売上増については、12 月に海外子会社や海外への直接販売の前倒し受注が大きく伸び、1~2 月に入ると減少する傾向がある。その影響で、第 3 四半期は売上・利益とも伸長した。第 4 四半期については、12 月の前倒し受注の反動減が見込まれることから保守的に計画している。粗利益率は、数量が増加するほど上昇する。また当社の賞与は業績連動のため、第 3 四半期の好調を受けて第 4 四半期の賞与が増加する見通しである。さらに工場の生産設備の補修や空調の新規設置を第 4 四半期に集中的に行う予定としている。

スマートフォン向けパッケージの変化は、今後どのように進むと考えているのか。

バッテリーは大きくなっている一方で、より薄型化が進むものとみている。

(平成 26 年 2 月 4 日・東京)

* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

http://www.mec-co.com/ir/k_setsumei/